证券代码：688362　　证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 ☑现场参观 □其他　（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中邮基金、易方达基金、景顺长城基金、广发证券、甬兴证券、华安证券
时间	2024 年 3 月
地点	广州香格里拉大酒店/公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	**1. 公司目前介绍？** 公司于 2017 年 11 月设立，位于中意宁波生态园区，公司主营业务为集成电路的封装与测试，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的中高端先进封装领域，并根据客户需求提供定制化的封装技术解决方案，在射频前端芯片封测、AP 类 SoC 芯片封测、触控 IC 芯片封测、WiFi 芯片封测、蓝牙芯片封测、MCU 等物联网、电源管理芯片、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域具有良好的市场口碑和品牌知名度。公司被评为国家“集成电路重大项目企业名单”。 **2. 去年营收上升但净利润/毛利下滑，可以分不同的业务板块/领域进行分析吗？对于 2024 年公司有什么发展规划？** 报告期内，公司受外部经济环境及行业周期波动影响，全球终端市场需求依旧较为疲软，整体价格承受一定压力；此外，公司二期项目陆续投产，产能爬坡过程中人员、能源动力、固定资产折旧等固定支出较高。上述情况综合导致公司本报告期毛利率有所下滑

	从下游客户应用领域主要包括射频前端、物联网、通信、安防、运算类芯片、汽车电子等。 从发展规划来看，一方面，公司继续深耕现有市场，提升现有客户特别是大客户的服务能力，努力提升市场份额，同时积极发展车规、工规产品线，并作为长期战略市场持续进行精耕细作，拓展公司产品应用领域。另一方面，持续完善公司自身产品线布局，积极推进 Bumping、晶圆级封装、FC-BGA 等产线的实施。 **3. 公司跟台系大客户的合作进展？公司为台湾客户代工什么类型的产品？** 公司新客户拓展顺利，覆盖了多种封装形式。 **4. 从毛利率的角度来看，去年和今年大概是什么样的情况？今年的折旧趋势能展望一下吗？** 去年毛利与营收呈现逐季度持续增长的态势。决定毛利的因素主要是价格端和成本端，价格端目前较为稳定；成本端主要是制造费用占比较高。不考虑新增投资的情况下，随着公司营收规模的扩大，会摊掉更多的成本，对毛利率也有一定的正向提升作用。 随着公司二期持续投资扩产，折旧总额也会逐步攀升。但随着营收规模的增长，规模效应逐步显现，折旧会有所摊薄。 **5. 公司目前的稼动率情况和价格水平是什么样的？** 目前公司稼动率良好；价格趋势主要取决于市场供求情况，同时也受具体的产品和客户的产品结构影响。目前整体来说价格处于一个相对稳定的状态。 **6. 2.5D 技术下半年的具体进展？** 公司在积极布局相关领域，目前在有序推进中。 **7. 2024 年股权激励目标和营收目标？** 根据公司于 2023 年制定的限制性股票激励计划，2024 年公司层面业绩考核目标 100%归属比例为 2024 年定比 2022 年

	营业收入增长率不低于 50%，即不低于 32.55 亿元。 **8. 可以讲一下公司未来在先进封装这一块的进展和具体工艺吗？以及公司先进封装工艺的团队来源？** 公司坚持深耕先进封装市场，不断提升技术实力公司二期规划投资 110 亿，目前包括 Bumping、晶圆级封装项目进展顺利，同时积极布局 Fan-out/2.5D 等领域，积极打造成为客户提供大 Turnkey 的优质封测供应商之一。 公司高度重视人才队伍建设，创始团队与核心团队中的大部分人员具备丰富的行业经验、技能、资源，对封测行业有着深刻的理解。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 11 日